
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

我們未來計劃的詳情載於「業務 — 業務戰略」一節。

[編纂]用途

我們估計[編纂][編纂](經扣除[編纂]及本公司就[編纂]應付的估計[編纂]，並假設每股[編纂]的[編纂]為[編纂]港元，即指示[編纂]範圍的中位數)合共約為[編纂](約等於[編纂])(假設[編纂]未獲行使)。我們當前擬將[編纂]按下列方式使用：

- 約[編纂]%(即[編纂](約等於[編纂]))將用於擴充我們的產能，分配如下：
 - (i) 約[編纂]%(即[編纂](約等於[編纂]))將用於南通二號廠房的生產環境裝修及建設。我們計劃興建防靜電室、不同等級的無塵室、供大型機器使用的高樓底生產空間以及自其他行業潛在客戶要求的其他生產空間；
 - (ii) 約[編纂]%(即[編纂](約等於[編纂]))將用於購置磨床、銑床、高速加工機及線切割機等生產機械與設備，以擴大垂直整合規模，製造更多零件供自身使用及全面擴充產能；
 - (iii) 約[編纂]%(即[編纂](約等於[編纂]))將用於招募及培訓新僱員以於改造及搭建後運營南通二號廠房；
- 約[編纂]%(即[編纂](約等於[編纂]))將用於開發及收購工程及技術知識，分配如下：
 - (i) 約[編纂]%(即[編纂](約等於[編纂])) 將用於內部培訓，即向員工提供培訓及發展機會以及招聘具光學、雷射、控制軟件及材料科學等經驗及整體科學和工程塑料加工、專業表面處理及精密機器框架及鈹金加工方面的技術知識等專業知識的人才，有助我們向半導體後段設備行業以外的行業擴展；及

未來計劃及[編纂]用途

- (ii) 約[編纂]% (即[編纂](約等於[編纂])) 將用於物色可能的機會以併購具備經驗／全面技能及技術且有盈利的公司。我們擬併購的業務種類包括精密框架製造商、金屬板製造商、工程塑料部件複雜配置加工商及表面處理工廠，均為半導體加工設備行業適用的技術知識型業務。截至最後可行日期，我們尚未物色到併購目標；
- 約[編纂]%(即[編纂](約等於[編纂]))將用於擴大日本、歐洲及美國的市場份額，分配如下：
 - (i) 約[編纂]%(即[編纂](約等於[編纂]))將用於在日本設立額外辦事處和擴大日本的銷售團隊及客戶服務團隊；
 - (ii) 約[編纂]%(即[編纂](約等於[編纂]))將用於市場活動，例如參與貿易展覽及行業活動和與潛在客戶建立關係(例如實地訪問)；
 - (iii) 約[編纂]%(即[編纂](約等於[編纂]))將用於在美國及歐洲國家委任市場推廣代理；
- 約[編纂]%(即[編纂](約等於[編纂]))將用於研發活動，例如支持自有「Kinergy」品牌產品及日後研發項目的發展。我們亦會增聘人員及購買粒子計數設備等先進研發設備；
- 約[編纂]%(即[編纂](約[編纂]))將用作營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定於每股[編纂][編纂]港元(即指示[編纂]上限)、每股[編纂][編纂]港元(即指示[編纂]下限)或兩者之間的任何價格，則我們擬按比例將[編纂]用於上述用途。倘[編纂]獲全部或部分行使，則我們擬按比例將[編纂]獲行使所得的額外[編纂]用於上述用途。

倘本公司董事決定大幅度將擬定用途的[編纂]重新分配於其他業務計劃及／或本集團的新項目及／或對上文所述的[編纂]用途作出任何重大調整，則我們會及時作出適當的公佈。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]毋須即時用作以上用途或我們未能落實任何部分擬進行的未來發展計劃，則我們或會將有關資金存放於持牌銀行或認可金融機構作為短期存款，期限以符合我們的最佳利益者為準。